

「レーザー技術が切り拓く近未来」

新規事業を画策するための無料セミナー

半導体レーザーは、光通信、給電、センサー、ディスプレイ、標識、医療、精密加工、自動車、建築、構造物の維持管理等、様々な分野で新しい応用展開が進んでいます。

名城大学ではレーザーの光取出効率の分野に於いて世界レベルの研究を続けておりますが、その中心研究者である上山教授が5年後に到達する目標を前提に、上記分野においてどんな変化が起こり得るか展望します。そこから、生まれる新事業について、参加者とともに自由な討論をする機会にできたらと思います。

- 日時:平成30年 12月4日(火) 13:30 ~ 16:30
- 場所:名城大学 天白キャンパス タワ-75 15階レセプションホール
<https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/tempaku.html>
 名古屋市天白区塩釜口1-501 電話 052-838-2036
 学術研究支援センター sangaku@ccml.meijo-u.ac.jp



■ プログラム	
13:30~13:35	主催者挨拶等
13:35~14:50	「レーザー技術が切り拓く近未来」 (Materials Research Society Fall Meeting学会の報告含む) 名城大学 理工学部 教授 上山智氏 レーザー素子が5年後に到達するであろう性能向上を前提に、光通信、センサー、ディスプレイ、精密加工など、各適用分野で起こり得る変化について最新の学会情報を紹介しながら展望します。
15:00: ~ 15:50	「国内展示会情報の紹介・報告」 名城大学 学術研究支援センター 科学技術コーディネータ 松吉恭裕氏 河合和彦氏 古林和典氏 レーザーの応用が各分野でどう展開されているか、最新の展示会情報から紹介します。 そこから今後求められる要素技術について参加者の皆様と考えていきたいと思ひます。
16:00: ~ 16:30	全体質疑応答・自由討論

- 申込方法 下記申込書にご記入の上、11月30日(金)までにFAX又はMailでお申込み下さい。
 Fax. 052-833-7200 Mail sangaku@ccml.meijo-u.ac.jp

ふりがな	
会社名	
所在地	〒
ふりがな	
所属	
氏名	
連絡先	TEL FAX
	メールアドレス